

电子封装技术丛书--先进倒装芯片封装技术



[电子封装技术丛书--先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)

著者:唐和明 (Ho-Ming Tong) 编

[电子封装技术丛书--先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)

标签

评论

很好的书，推荐大家好好看看

好书，很好的参考资料，应该对我们的工作有参考价值

很实用的一本专业书，多次购买商品

书本到货很快 质量也可以

这书不值这么贵，没有多少先进的内容

好好瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

找时间看，再评价

印刷质量不错，讲的内容挺系统的，需要慢慢研读。

书还是不错，但是对京东物流包装一点不满意，书都坏了。

书内容不错，送货及时，就是拆开封面稍微有点脏。

帮别人买的。具体怎么样我也不知道。应该还不错吧。

送货速度快，服务态度好

很好，工作需要

书还不错～纸张挺好的 介绍很全面～

京东品质很棒 东西保了性价比高 派件速度很快

小贵，书不错

棒，总在这里买的，速度棒。京东就是好，服务一流。正版的书就是好

不忘初心，牢记使命，为新时代祖国的国防建设献出绵薄之力。

没啥好说的，书是正版，很新很满意

买过一本了，这次一激动又买一本

专业专著，行业进步必备，学习无止境 银子哗哗流

好好好好非常好，真是非常好，请通俗易懂

这部书还是比较实用的，可以看看。

印刷还行，买来学习一下。

不错！！！！！！！！

不错不错不错不错不错

还可以，就是有些工艺没有细说

价格挺贵的，但是知识无价，学无止境

用起来还可以，讲的比较详细。

绝对正版，物流速度超级快，买书就上京东

物美价廉，值得购买。物美价廉，值得购买。

很好的专业书籍

等待的时间太长了，等得花儿都谢了！

到手的书第一页就已经裂开了。估计过两天就掉页了，随手一翻有一个地方多加了好几页内容，第七章那里有第九章的内容，虽然不影响阅读，但是看出来出版社很粗心，这么贵的书装订水木太差100多块钱的书给人感觉这么差的装订，太掉价了，而且内容少，参考文献估计都占一半了。。给两星是给作者的，算是比较新的讲TSV的吧，偏重工艺。插一句上次在JD买书书有漏页现象，后面换了。这次又碰到装订问题不想换了，麻烦JD采购多多注意渠道。虽说是概率事件但是连续两次碰到这个问题，就有点说不过去了。

刚收到，还没看，破了一点，有点脏，其它还好。

好歹也是*钱的书，直接用盒子装上发了过来，书角破了，退也麻烦，只是感觉包装这块越来越随意

速度快

好好

符合

书是正版，印刷什么的也是没问题，但是最重要的内容实在太烂了，属于行业协会骗钱的书。

好

赞

介绍较简单，不过挺全的

不错的 图书

阿门的专业书籍~~~

还没看，其实想买微电子封装那本书的，可惜没货，都大半年了

专业正版图书质量好，价格公道，内容全面，讲解详细，送货快速！

好书就是贵

你这个书的一看就是做封装的屌丝啊，悲惨

书满意，正在学习中。。。。。

很实用的专业书！值得一看！

很详细，作为参考书不错。

面广，有内容，详细，但深度不够，专业人看看就当扩冲知识面了

书不错，发货耶跟迅速

帮单位买的书，都挺好的

购物一直选择京东，发货快

挺不错的一本教材书籍。

好书大家一起看，部门买的。

第一次京东上买书，正版，还可以

电子封装技术丛书：电子封装工艺设备

帮公司买的。同事说原版很好，翻译版还没看。

书是正版，印刷质量好

印刷质量很好，是正版图书；很多书籍没有都是从外地调货过来，不过送货速度很快；内容还没仔细研究，不过都是师兄们介绍，或者网上评价比较好的，希望对自己真的有用；一次买了好多本，用到的时候查阅起来比较方便，总之，很赞。

还可以还可以还可以还可以

相当不错！！！！！！！！

书还比较好，但是价格还是偏高

快递很给力，质量很不错

书肯定是好的，价钱有些受不了。

这个书知识很系统，非常好看~

这本书结合国内行业现状，写的很好，值得学习。希望以后还能出这样好的专业书籍。

专业用书，很经典，就是贵了点

专业书，买到还打着，货到无破损，没什么不好的。

最新的书，并且自豪的是，自己公司的产品也是这本书里面的主角

买书看学习中，不知道学习能不能耐得住

质量不错，就是有点贵

很全面的一本电子封装工艺专业书

品相好，和书店一模一样，好评

本来是买给女儿看的自己先看了一遍经典就是经典语言朴实却那么有感染力励志电子封装技术丛书电子封装工艺设备，书一到手上就迫不及待地读了书中的内容精彩绝伦文如其人一贯的个人风格凸显的作品喜好明晰，阅读了一下写得很好电子封装技术丛书电子封装工艺设备全面、系统地介绍了各级电子封装工艺所使用的封装设备、各种类型集成电路测试系统、测试辅助设备和半导体封装模具。全书通过封装工艺的简述引出设备，分别论述了电子封装工艺设备在电子和半导体封装工艺中的作用和地位，较系统地介绍了电子和半导体封装不同工艺阶段所对应的封装设备的工艺特点、工作原理、关键部件及应用的代表性产品示例。并针对目前先进封装技术和封装形式对工艺设备提出的新的需求，对未来微电子封装工艺设备的发展趋势做了展望。电子封装技术丛书电子封装工艺设备对电子和半导体封装及相关行业的科研、生产、应用工作者都会有较高的使用价值，对高等院校相关专业的师生也具有一定的参考价值。这本书，可以让人冷静下来思考生活的一切。叙事流畅观点不流于世俗却又非常接地气时不时地让你莞尔一笑那是发自内心的认同塑封压机的工作过程主要分为合模和注塑两个部分，其工作过程如下。
·合模部分活动工作台快速上升-慢速上升-次加压-二次加压—合模保持-活动工作台卸压-慢速下降-快速下降-慢速下降-活动工作台维持-油缸（升降工作台）卸压-慢速上升。
·注塑部分上柱塞杆快速下降—一次慢速下降—二次慢速下降-三次慢速下降（注塑结束）—卸压-慢速上升-快速上升-慢速上升。要实现上述的工作程序，可采用比例控制技术来实现电磁比例阀对液压系统的压力、流量和方向进行无级调节。其基本工作原理是根据输入电信号电压值的大小，通过比例放大器，将该输入的电压信号转换成相应的电流信号。电流信号作为输入量被送入比例电磁铁，从而产生和输入信号成比例的输出量——力和位移。该力和位移又作为输入量加给电磁比例阀，后者产生一个与前者成比例的流量或压力。塑封压机主要是通过可编程逻辑控制器（）控制液压系统中各功能阀件的开启而控制整个系统的压力与速度，来完成合模与注塑工作的。衡量塑封压机的主要技术指标有两台面的平行度、注塑杆与台面的垂直度及压力的稳定性。②塑封压机液压系统原理塑封压机液压系统主要是通过来控制液压系统的各阀件的开启，并通过液压模块来分配油路，然后通过电磁比例阀来控制流量与压力，从而达到控制合模和注射的速度与压力。塑封压机的液压系统可分为高压和低压两大部分。由高压泵、电磁换向阀、溢流阀、远程调压阀及主油缸、辅助油缸等共同组成主高压系统，其余的则由低压泵提供动力源以组成辅助动作和控制作用的低压系统。根据塑封压

还没来得及细看，浏览了一下内容不错

不错啊，京东买书放心

知识就是力量 多看书有助于工作

封装电子协会作了件好事，也老了钱

书还可以，内容也还行，就是价格有点贵！

：电子封装工艺设备 挺好的

封装工艺设备方面难得的系统化的好书

[电子封装技术丛书--先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)

书评

[电子封装技术丛书--先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)